BEST CREDIT & CREATIVITY

반도체 신소재 부품의 GAME CHANGER

2026.11

비씨엔씨(주) 1124 감세악 BCNC-182 2026-11-10, 17:12:27

Disclaimer

본 자료는 회사의 영업활동에 대한 이해증진을 위해 비씨엔씨㈜ 이하, “회사”에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

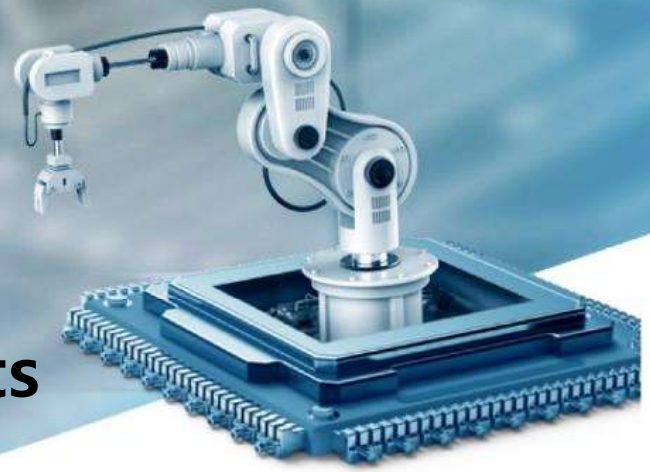
본 자료에 포함된 ‘예측정보’는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과 같은 단어를 포함합니다. 위 ‘예측정보’는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 ‘예측정보'에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 향후 전망은 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경 될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 또한 조직개편에 따른 사업부문 재분류 등으로 기존에 공시한 재무정보와 차이가 있을 수 있습니다. 본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 임직원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.(과실 및 기타의 경우 포함)

본 자료는 기업 비밀이 포함된 자료로서 무단 복제 및 배포를 삼가하여 주시기 바랍니다.

비씨엔씨(주) 1124 김세익 BCNC-182 2026-11-10, 17:12:27

BEST CREDIT & CREATIVITY

반도체 신소재 부품의 GAME CHANGER



Contents

1. About 비씨엔씨
2. 경영성과
3. 반도체 부품시장 전망
4. 글로벌 반도체 소재 전문기업, 비씨엔씨
   1) 합성쿼츠 QD9+ 소재 양산
   2) CVD-SIC 대체소재 CD9 개발
   3) Si Ingot 소재 양산
   4) BC-T1 소재 개발 프로젝트
   5) 글로벌 Top tier로 도약

Appendix

비씨엔씨(주) 1124 김세악 BCNC-182 2026-11-10, 17:12:27

Corporate Identity

Global 반도체 소재•부품 산업의 "Game Changer", 비씨엔씨

세계 최초 반도체용 합성쿼츠(QD9) 부품 개발



- 기존 천연쿼츠 부품의 한계 극복한 Premium 부품 개발 및 양산
- Etching 공정의 핵심 부품 공급
- Non-Micro Bubble에 따른 Particle 감소

독보적인 기술&제조 경쟁력 보유



- 독보적 정밀가공 및 표면처리 기술 통한 양산 능력 확보
- Particle 발생을 방지하는 부품 가공 기술
- 특화된 표면 처리 기술 : Chemical treatment, Fire polishing, Mechanical polishing

국내외 고객사와의 견고한 Partnership



- 글로벌 Chip-Maker & 반도체 장비 업체 고객사 확보
- Chip-Maker내 채택률 증가: AI 확산에 따른 메모리의 초미세화 및 초고단화 추세

글로벌 반도체 소재 전문 회사 도약 (주요 소재 국산화)



- 합성쿼츠 소재 국산화(QD9+)
- CVD-SiC 대체 차세대 소재 B4C(CD9)개발 및 양산
- 다결정/단결정 Si 소재 국산화(SD9+P/SD9+S) 양산
- 백앤드용 세라믹 소재(보론 베이스) 개발 중

비씨엔씨(주) 1124 김세익 BCNC-182 2026-11-10, 17:12:28

회사 개요

회사 개요

회 사 명	비씨엔씨㈜ / BCnC
대 표 이 사	김돈한
설 립 일	2003년 6월 19일 (상장일 2022년 3월 3일)
자 본 금	64억원
임 직 원	316명 (2026년 09월말 기준)
주 요 사 업	합성쿼츠(QD9+ & QD9), 천연쿼츠, Silicon(SD9+P & SD9+S), Ceramic(CD9 등) 등을 활용한 반도체 소재 및 부품 제조/판매
본 사	이천시 신둔면 마소로 57번길 25
여 의 도 사 무 실	서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 타워1, 5층
홈 페 이 지	http://www.bcnc.co.kr/

CEO Profile



대표이사 **김 돈 한**

- 안동대학교 회계학과
- 듀라소닉
- 미코엔에스피 대표이사
- 現) 비씨엔씨 대표이사
- 반도체 분야 경력 34년

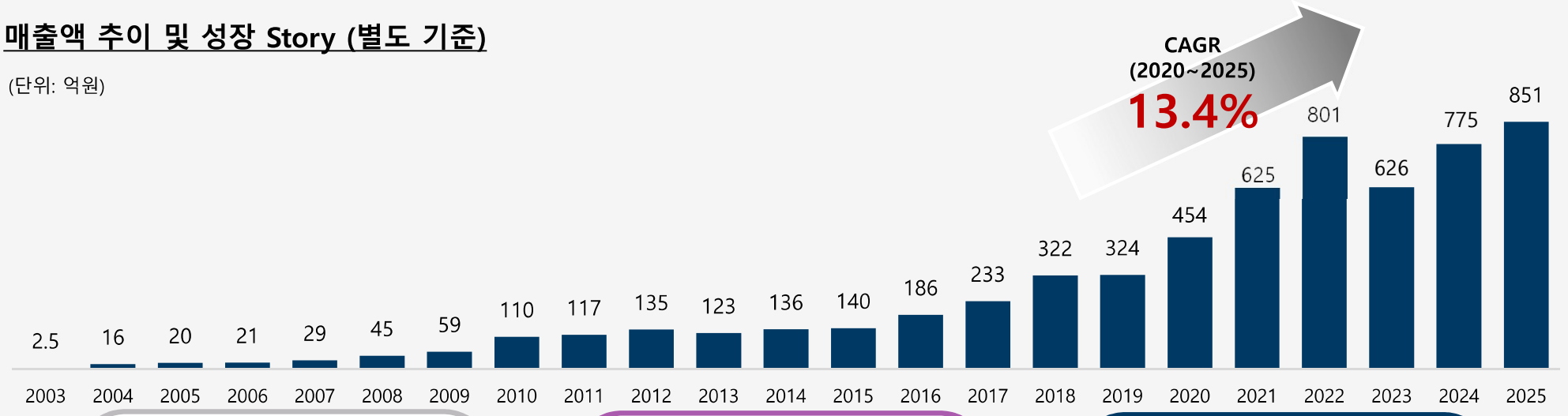
비씨엔씨(주) 1124 김세악 BCNC-182 2026-11-10, 17:12:28

성장 연혁

반도체 소재&부품 개발 및 글로벌 Chip-Maker와의 협력 기반 성장 본격화

매출액 추이 및 성장 Story (별도 기준)

(단위: 억원)



(설립일 ~ 2009)
반도체 공정용 부품 사업 기반 구축

(2010 ~ 2016)
합성쿼츠 부품 고객사 확대

(2017 ~)
반도체 소재·부품 전문 기업으로 도약

2003 비씨엔씨㈜ 설립
SK Hynix, DB HiTek 공식업체 등록
일본, 대만 수출 개시
2007 TOSHIBA 공식업체 등록
2008 합성쿼츠 부품 개발
2009 합성쿼츠 부품 양산 및 공급

2010 사업장 확장 및 본사 이전
2011 가공 1공장 증축
2012 기업부설연구소 설립
2013 BCnC USA, LLC 설립
2014 SAS(삼성전자 미국법인) 합성쿼츠 부품 공급
2015 SK하이닉스 합성쿼츠 부품 공급
2016 비씨엔씨시스템㈜ 인수
SAS / Infineon / TI / TJ / X-Fab / NXP / SSMC 등 공식업체 등록

2017 QD9 소재 개발 및 시제품 테스트
2018 CD9 소재 개발 개시
삼성전자 IMK 공식업체 등록, TSMC 공식업체 등록
2019 QD9 소재 양산, 삼성전자&SK하이닉스 QD9 제품공급
비씨엔씨머터리얼즈㈜ 설립
2020 QD9+ 소재 개발, 인텔 QD9 공급, 가공 2공장 설립
2021 삼성전자 공식업체 등록, NET 인증, 가공 3공장 설립
QD9+ 소재 공장 설립, 마이크론(일본) QD9 공급
2022 1Q 인텔 양산 수주 확보. 4Q QD9+ 양산 개시 (1호기)
2023 가공 4공장 설립, 4Q QD9+ SK하이닉스, 삼성전자 공급
2024 SD9+ 소재 개발 및 양산. CD9 소재 양산
2025 QD9+ 북미 A사, B사 공급, SD9+ 북미 A사 공급, CD9 B사 공급

주1) QD9 : Synthetic Quartz(합성쿼츠)를 반도체 Etch 공정에 적합하도록 tuning한 소재이며, BCnC 자체 브랜드
주2) QD9+ : 합성쿼츠를 국산화, 내재화한 소재이며, BCnC 자체 브랜드
주3) CD9 : Boron Carbide를 반도체 Etch 공정에 적합하도록 tuning한 소재이며, BCnC 자체 브랜드
주4) SD9+ : 차세대 디바이스 공정용 실리콘 부품으로 국산화 소재이며, BCnC 자체 브랜드

비씨엔씨(주) 1124 감세악 BCNC-182 2026-11-10, 17:12:28

주요 소재별 제품 Line-up

프리미엄 제품 – QD9+ & QD9(합성쿼츠), CD9, SD9+P
일반제품군 – 천연쿼츠, 싱글 실리콘, 세라믹 등

합성쿼츠(QD9+ & QD9)

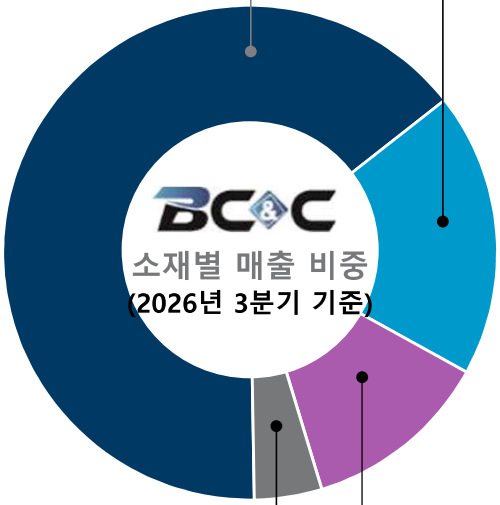


[RING]

천연쿼츠



[RING]





[Sapphire]



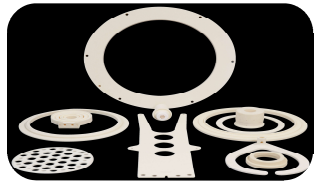
[Sapphire]



[CD9]



[Silicon]



[Ceramic]

기타

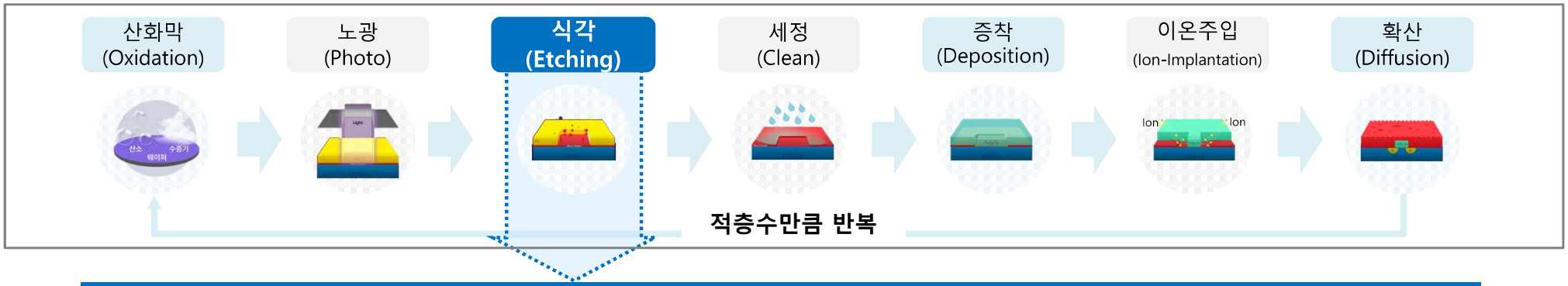
CD9, 실리콘, 세라믹

비씨엔씨(주) 1124 감세악 BCNC-182 2026-11-10, 17:12:29

반도체 Value Chain과 비씨엔씨

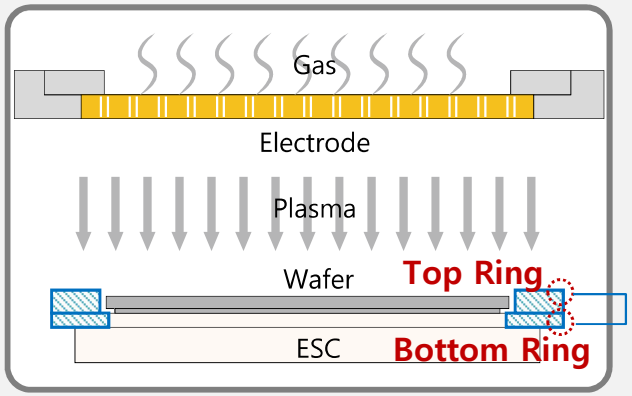
반도체 전공정 중 소모품 비중이 가장 큰 Etching 공정 핵심 부품 공급

반도체 전공정 Process



식각(Etching)			
구분	Poly Etching	Oxide Etching	Metal Etching
점유량	60%	25%	15%
주요 부품	Quartz	Si, CVD SiC	Al_2O_3 등

Dry Etching Chamber 구조



합성쿼츠 Ring



QD9+ & QD9

비씨엔씨(주) 1124 김세익 BCNC-182 2026-11-10, 17:12:30

2026년 3분기 실적

2026년 3분기 매출액 303억원, 영업이익 20.3억원(분기 최대치)

■ 경영 성과 요약 (별도 기준)

(단위:백만원)

구분		당분기실적	전분기실적	QoQ(%)	전년동기실적	YoY(%)
		26.3Q	26.2Q		25.3Q	
매출액	당해실적	30,337	27,272	3,064 (11.2%↑)	21,969	8,368 (38.1%↑)
	누계실적	80,628	50,292		62,148	18,480 (29.7%↑)
영업이익	당해실적	2,031	1,673	358 (21.4%↑)	1,421	610 (43.0%↑)
	누계실적	4,545	2,514		3,212	1,333 (41.5%↑)
당기순이익	당해실적	844	1,753	-909 (51.9%↓)	1,661	-816 (49.2%↓)
	누계실적	2,973	2,129		867	2,106 (243.1%↑)

주요 성과

■ H社 '26년 QD9+ 확대 전개 진행 중, 천연쿼츠 대체 & QD9을 QD9+로 전환 추진

■ H社 '24년 하반기 CD9 Qual test 완료, 25년 양산 공급 개시

■ 해외 고객사들에 QD9+ 및 SD9+ 양산 공급 개시

향후 주요 이슈 및 성장 전략

■ QD9+ 소재 부품의 국내외 양산 공급 확대

■ CD9 국내사 양산공급 확대 및 국내외사 테스트 확대

■ SD9+ 해외 고객사 양산 공급 확대 및 국내외사 테스트 확대

■ QD9+, CD9, SD9+P 소재 수율 개선

■ 반도체용 국산화 소재 테스트/개발 중 : BC-T1

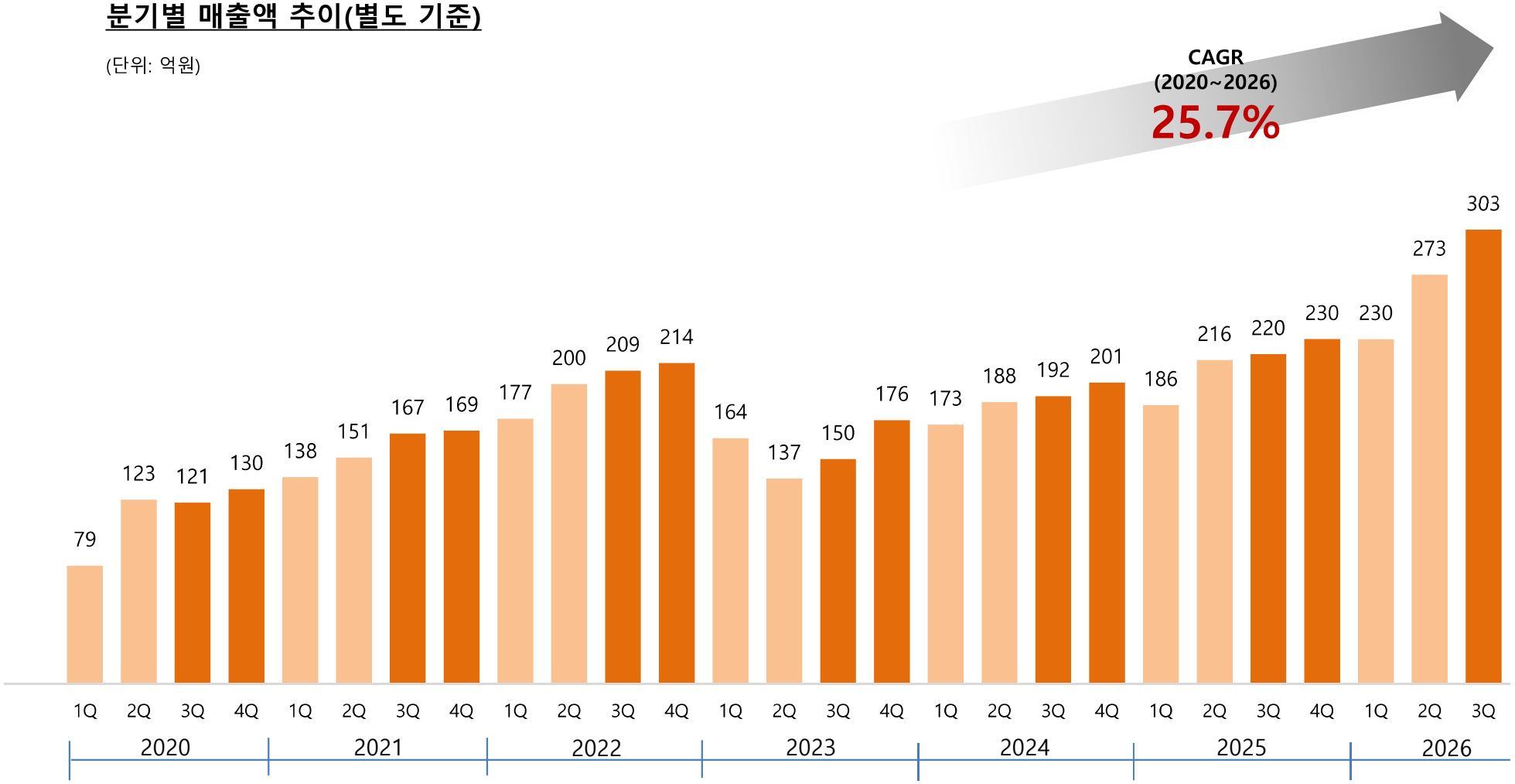
비씨엔씨(주) 1124 감세악 BCNC-182 2026-11-10, 17:12:30

분기별 매출액 추이

반도체 소재&부품 개발 및 글로벌 Chip-Maker와의 협력 기반 성장 본격화

분기별 매출액 추이(별도 기준)

(단위: 억원)

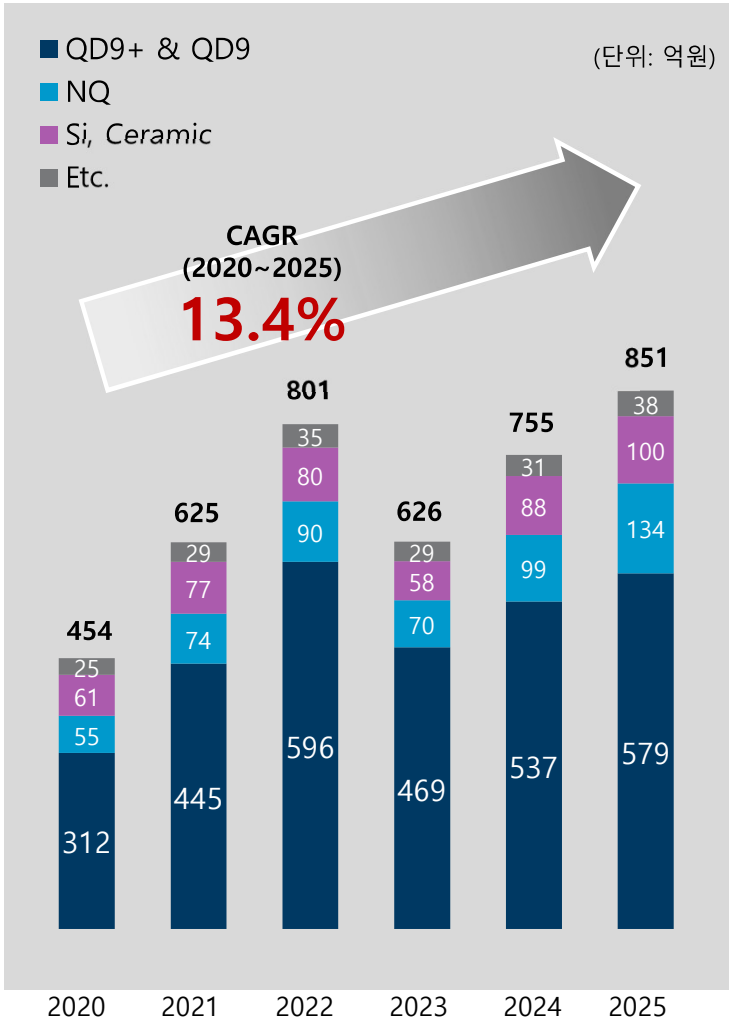


비씨엔씨(주) 1124 감세악 BCNC-182 2026-11-10, 17:12:30

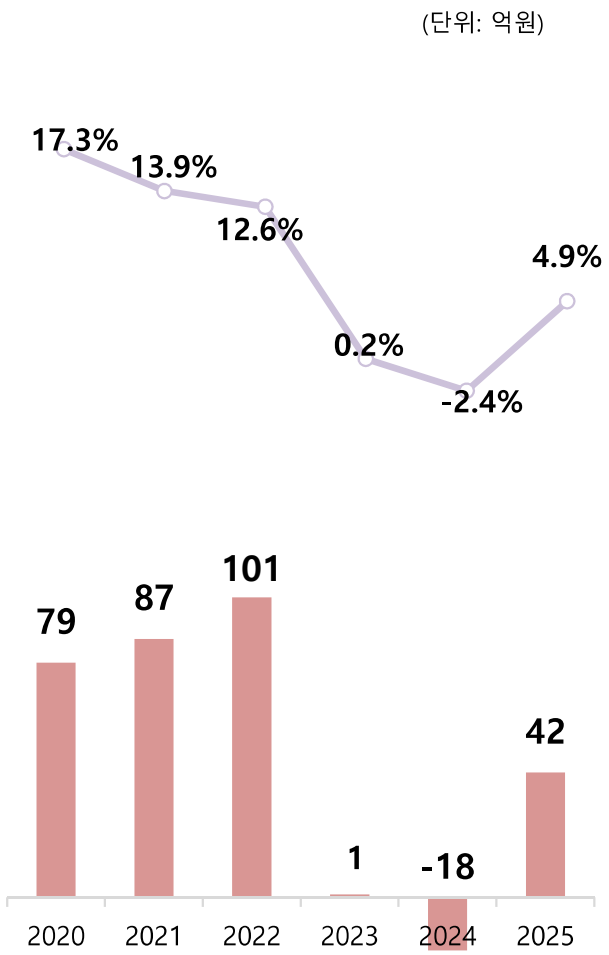
연간 실적 추이

반도체 소재&부품 개발 및 글로벌 Chip-Maker와의 협력 기반 성장 본격화

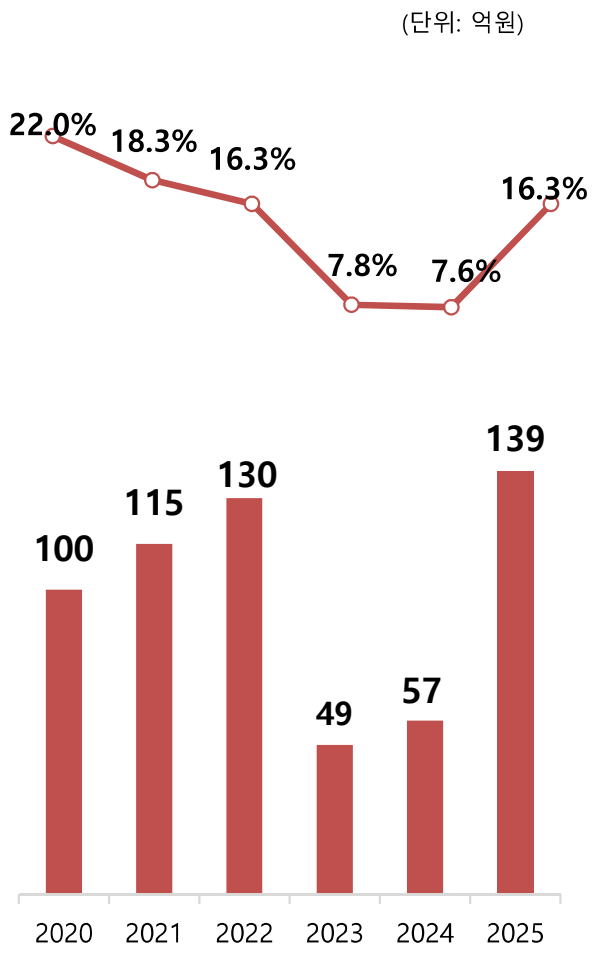
소재별 매출액 추이(별도 기준)



영업이익 및 영업이익률 추이



EBITDA 및 EBITDA 마진



주1) QD9+ 매출액을 2024년부터 반영

비씨엔씨(주) 1124 감세악 BCNC-182 2026-11-10, 17:12:30

미래 산업 내 High Device 수요 견조

AI, 데이터센터, 메타버스, 자율주행 등 High Device 수요 지속적인 증가

미래산업을 중심으로 적용 Application 확대



반도체 공정의 초미세화, 초고단화

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Logic	10nm	7nm	5nm		4nm	3nm	2nm	
DRAM	1X	1Y	1Z		1A		1B	1C
3D-NAND	x64	x96	x128		x152/192	x256	>300	>400

※자료: ASML

[필요 반도체 특성]

대용량 데이터 처리 필요 + 데이터 처리 속도 극대화 + 전력 소모량 최소화 »

High Device 수요 증가

« 미세화로 인한 Multi Patterning + 고단화로 인한 Multi Stacking + 고출력 플라즈마 파워 형성 요구

[공정 특성]

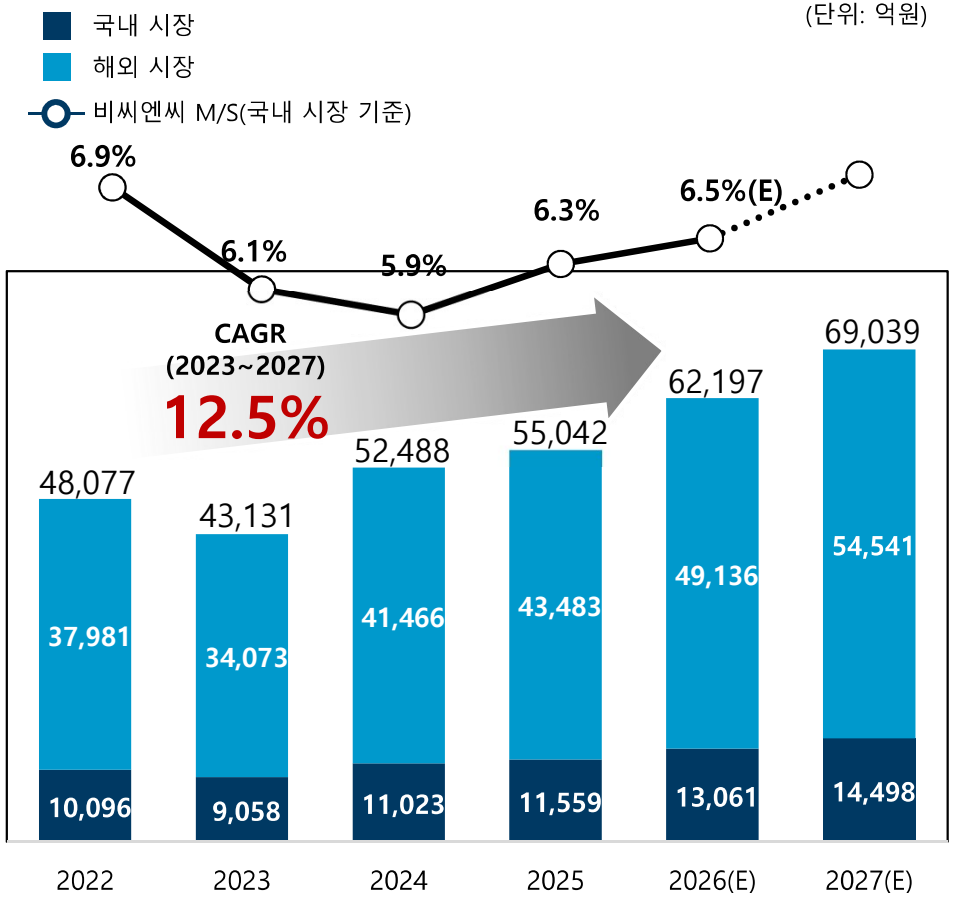
High Device 제조공정의 부품 핵심 Vendor, BCnC

비씨엔씨(주) 1124 김세익 BCNC-182 2026-11-10, 17:12:31

글로벌 반도체 부품 시장 전망

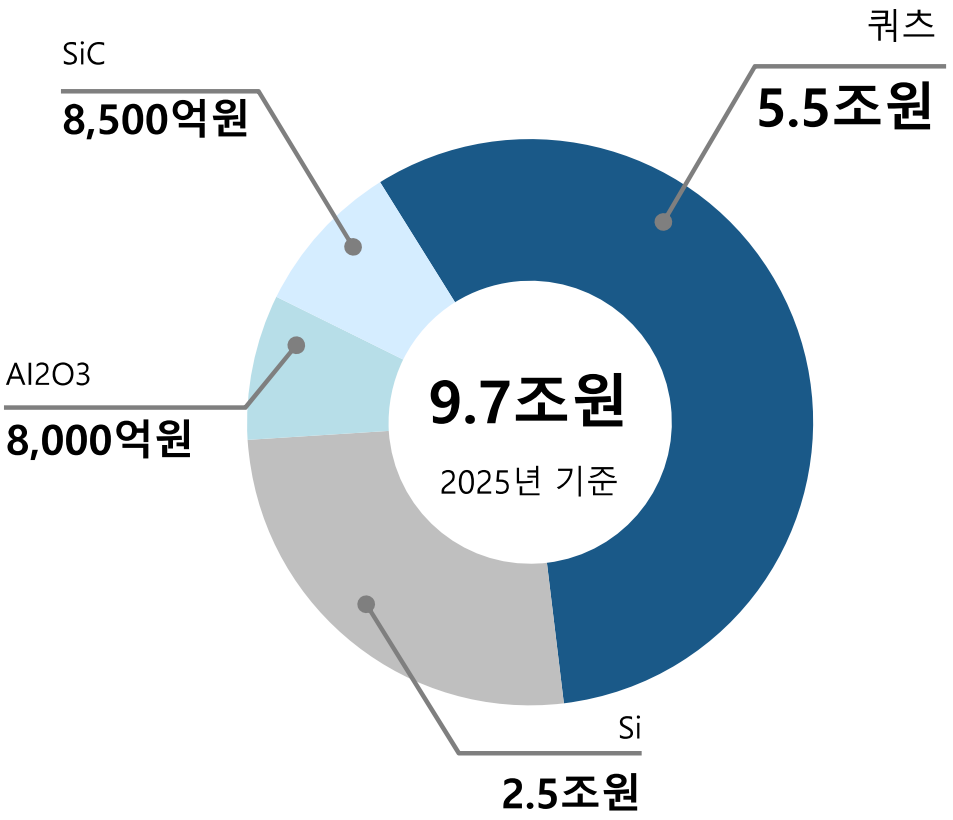
전세계 쿼츠 부품 시장은 약 12.5%의 연평균성장률 예상

국내[1], 해외[2] 쿼츠 부품 시장 규모



주1) 국내 쿼츠 부품 시장 규모는 금융감독원 Dart 전자공시시스템에 발표된 국내 쿼츠 부품 공급업체의 쿼츠 매출액과 국내 증권사 산업 분석 리포트를 기준으로 추정
주2) 글로벌 쿼츠 부품 시장 규모는 한국이 글로벌 반도체 생산량의 21% 수준이므로 2026년도 기준, 약 6.2조원 역산 추정
주3) 향후 시장 규모는 SEMI 또는 WSTS 등의 반도체시장 전망 자료에 의해 추정함

소재별 반도체 공정용 부품 시장 규모



※ 자료: 당사 추정

비씨엔씨(주) 1124 감세악 BCNC-182 2026-11-10, 17:12:31

세계 최초 반도체용 합성쿼츠 부품 QD9 개발 및 양산 (2019년)

"QD9", 합성쿼츠를 반도체 Etching 공정에 적합하도록 자체 개발한 소재·부품

■ QD9(합성쿼츠)의 우수성

천연쿼츠	구분	QD9+
평균 1,000시간	**사용수명 (Single Ring)**	평균 1,500시간
낮음 (Micro Bubble로 인한 파티클 유발)	**생산 수율**	높음 (Micro Bubble 없음으로 인한 파티클 발생 없음)
낮음 (불순물로 인한 비정기 PM 발생)	**공정 안정성**	높음 (불순물로 인한 비정기 PM 없음)

End-User Benefit

***High Device* 적용!**



수율 증가

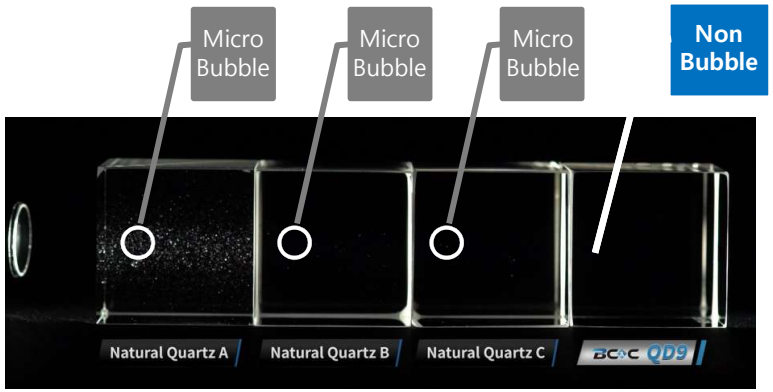


부품 수명 증가

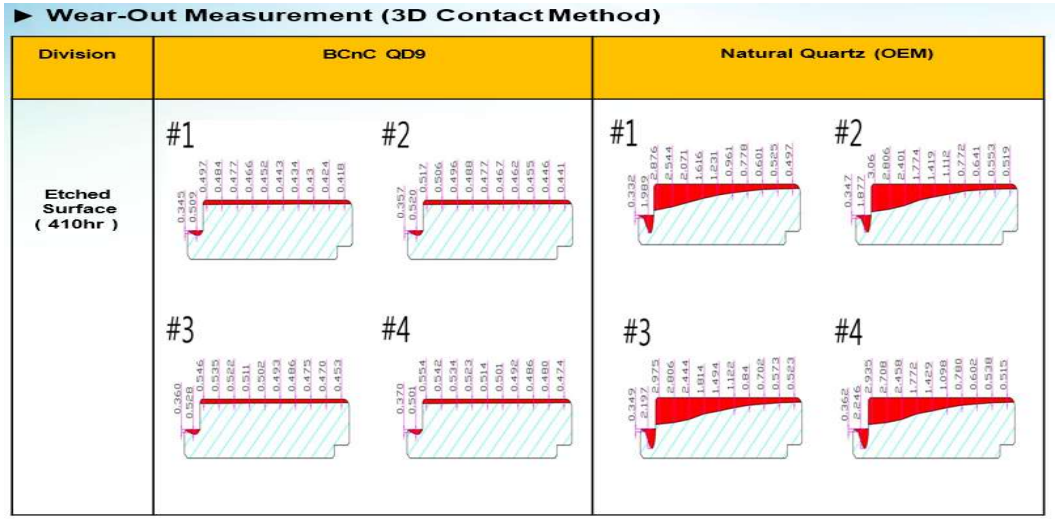


설비 가동율 증가

■ 마이크로 버블 발생 여부



※ 자료: 회사 내부 실험 결과



비씨엔씨(주) 1124 김세익 BCNC-182 2026-11-10, 17:12:31

QD9+ 소재 양산 성공 및 공급 확대 ①

세계 최초로 반도체 Etching 공정에 특화된 합성쿼츠, "QD9+" 양산 시작 (2022년)

(쿼츠 소재 생산국가 진입)

QD9
(해외 수입)

내재화 추진

QD9+ 개발 진행
- 원재료 Cost down
- 친환경(Toxic Gas 無) 제조
- 기존 소재 대비 우수한 특성

글로벌 소재 전문 기업으로 도약

	QD9		QD9+
제품 형태	▪ 매우 긴 공정시간 필요 ▪ 추가 가공 필요 (Solid type)		▪ 제품 형상 최적화 (Cylinder type) ▪ 짧은 공정시간, 가공시간 최소화
원재료 비용	높음 ▪ 원소재 생산 단가 높음 ▪ 높은 설비 비용 및 추가가공에 따른 가공 단가 증가 ▪ 유해 가스 발생으로 인한 처리 단가 증가		낮음 ▪ 공정시간 단축으로 원재료 전환 효율 우수 ▪ 형상 최적화를 통한 가공 단가 절감 ▪ 유해 가스 처리 비용 발생 X
친환경 제조	유해가스 발생 (HCl(유독가스), H_2O, CO_2)		유해가스 미발생 (H_2O, N_2, CO_2)
증착 효율	50%		75%

재료비/공정시간 절감 ⇒ 경쟁력 강화



비씨엔씨(주) 1124 김세익 BCNC-182 2026-11-10, 17:12:31

QD9+ 소재 양산 성공 및 공급 확대 ②

1) QD9+ 특성 외부 측정 결과

구 분	측정기관 / 측정일자	QD9+	타사 합성쿼츠	비 고
1. 불순물 함량 측정	JKC / 2021. 07.30	102.81ppb	6,348.72ppb	불순물 함량이 낮을수록 유리
2. 밀도 측정	Clare / 2021.07.29	평균 2.198(g/cm3)	평균 2.200(g/cm3)	일반적인 쿼츠 밀도인 2.2g/cm3 수준으로, 특이사항 없음
3. 식각율 측정	Clare / 2021.08.03	평균 12.072(g/cm3)	평균 12.467(g/cm3)	낮은 식각량으로 사용수명이 길어짐
4. 경도 측정	Clare / 2021.07.29	평균 849.3HV	평균 816.8HV	경도가 높을수록 식각 저항성이 우수

2) QD9+ 특허 보유 현황

특허 명칭 (등록번호)

1. 합성쿼츠 제조 방법 (제10-2388688호)
2. 수율 개선 및 기공 제어가 가능한 합성 석영유리 제조방법 (제10-2419522호)
3. 증착면 온도 균일제어가 가능한 합성 석영유리 제조장치 (제10-2419569호)
4. 반도체용 실린더형 합성쿼츠 제조기술 (제10-2452282호)
5. 사이드 버너를 이용한 실린더형 합성 쿼츠 제조방법 (제10-2419537호)
6. 반도체용 실린더형 합성쿼츠 제조를 위한 맨드릴 구성 (제10-2419547호)
7. 반도체용 실린더형 합성쿼츠 제조를 위한 맨드릴 구성 및 제조방법 (제10-2419554호)
8. 표면 결함을 개선시키기 위한 실리카 증착체 제조 방법 (제10-2419561호)
9. 향상된 증착 효율을 가지는 OVD 공정을 통한 합성 석영유리 제조방법 (제10-2388684호)
10. 반도체용 실린더형 합성 쿼츠 제조기술 (제10-2419565호)
11. 예비 버너를 이용한 대구경 실리카 수트의 크랙을 제어할 수 있는 장치 (제10-2612252호)
12. 버너와 맨드릴 표면간의 거리 제어를 통한 대구경 실리카 수트의 돌기를 제어할 수 있는 장치 (제10-2612247호)
13. 배선기능 개선을 통해 증착물의 표면결합을 방지할 수 있는 합성쿼츠 제조설비 (제 10-2636792호)
14. 힐링 증착 패스 공정을 통한 대구경 실리카 수트의 크랙을 제어할 수 있는 장치 (제 10-2659434호)
15. 합성 쿼츠 제조를 위한 버블 제거 장치 및 방법 (제 10-2727726호)
16. 구간별 열량 제어를 통한 대구경 실리카 수트의 크랙을 제어할 수 있는 장치 (제 10-2612244호)

국내 특허 등록 16건, 출원 8건
해외 특허 등록 6건, 출원 5건
(일본,미국,중국,대만 등)

비씨엔씨(주) 1124 김세익 BCNC-182 2026-11-10, 17:12:32

CD9 소재 양산 성공 및 공급 개시

CVD-SiC 대비 우수한 "CD9" 소재의 Focus Ring 개발 완료 및 양산 개시 (2024년)

기존 CVD-SiC 부품의 대체 수요 발생

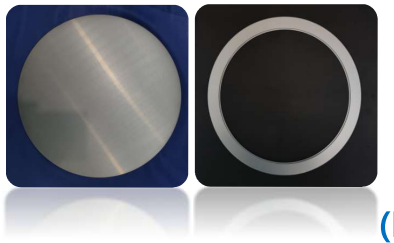


CVD-SiC Focus Ring
(Carbon 70%, Si 28%, 기타 2%)

CVD-SiC 사용 문제점

- Carbon에 의한 Particle 발생 증가
- 불량률 증가
- 부품 대체 수요 발생

CVD-SiC 단점 보완한 CD9 개발 완료



CD9 Focus Ring
(Boron 75%, Carbon 25%)

CD9 사용 확대

- 높은 공유결합에너지 → 고강도, 고내구성
- 우수한 플라즈마 내성 → 적은 Particle 발생
- 수율 유지 및 수명 증가 효과

"고객사 Test 진행, 논의 "

양산공급

A사

SAMSUNG 삼성전자 SEMES micron intel AMEC

비씨엔씨(주) 1124 김세익 BCNC-182 2026-11-10, 17:12:32

CD9 소재 양산 성공 및 공급 개시

1) CD9 특허 보유 현황

특허 명칭 (등록번호)

1. 실린더 또는 링 형태의 보론카바이드 소결체 제조방법 및 이를 이용한 플라즈마 장치용 엣지링 제조방법 (제10-2132251호)
2. 저항 조절이 가능한 반도체 제조용 부품 (제10-2177139호)
3. 입자성장을 억제한 고밀도 보론카바이드 세라믹 제조방법 및 제조된 세라믹 소결체 (제10-2249470호)
4. 열간가압 소결용 다층 적층 구조의 몰드 (제10-2310046호)
5. 파티클발생 최소화에 유리한 치밀한 보론카바이드 재질의 반도체 제조공정용 엣지링 및 그 제조방법 (제10-2419533호)
6. 보론카바이드 소결체 제조 장치 (제10-2419521호)
7. 프리프레스를 이용한 내플라즈마성 엣지링 제조방법 및 이에 따라 제조된 내플라즈마성 엣지링 (제10-2427219호)
8. 균일 도핑 내플라즈마성 소재 및 그의 제조방법 (제10-2487220호)
9. 전도성 레이어를 포함하는 포커스링 (제10-2488114호)
10. 식각률을 감소시킨 반도체 제조 공정용 웨이퍼 엣지링 (제10-2488114호)
11. 미립자를 첨가한 플라즈마 저항성 소재 및 그의 제조방법 (제10-2541331호)
12. 用於最小化粒子産生的具有緻密碳化硼層的半導體製造過程的 (제I837839호)
13. パーティクル発生の最小化に有利な緻密なボロンカーバイド材質の半導?製造工程用エッジリング及びその製造方法 (제 7486838호)
14. 반도체 제조공정용 엣지링 제조방법 (제 10-2687816호)
15. 플라즈마 장치용 보론카바이드 소결체 제조방법 및 이를 통해 제조된 보론카바이드 소결체 (제 10-2728022호)
16. 반도체 제조공정용 엣지링 및 그 제조방법 (제 10-2731305호)
17. 보론카바이드 소결체 제조장치 및 제조방법 (제 10-2774493호)

국내 특허 15건, 출원 3건 / 해외 특허 2건, 출원 2건

비씨엔씨(주) 1124 김세익 BCNC-182 2026-11-10, 17:12:32

Si Ingot 소재 양산 성공 및 공급개시 ①

1) "SD9+P"

차세대 디바이스 부품 소재, Poly Si(다결정) 잉곳부터 제품까지 수직계열화 (2024년)

SD9+P 양산화 → End-User Benefit

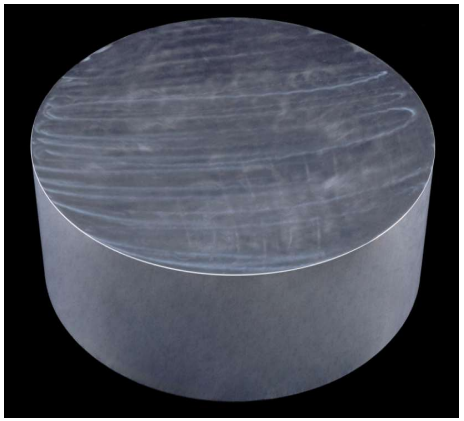

▪ 소재 국산화


▪ 소재/부품 안정적 공급


▪ 단가 경쟁력

▶ SD9+P Ingot

- Nitride Free 실리콘 잉곳 (품질 경쟁력 ↑)
  실리콘 부품의 품질/비가격 경쟁력 확보
  Large Parts 뿐 아니라 Focus Ring에도 적용 가능
- 소재 Loss율 최소화하기 위해 원형의 Ingot 성장 생산
- 시뮬레이션 프로그램 활용, Ingot 장비 핫 존 설계 및 생산


(BCnC SD9+P 잉곳)



(BCnC 폴리 실리콘 제품)



(타사 폴리 실리콘 제품)

비씨엔씨(주) 1124 김세익 BCNC-182 2026-11-10, 17:12:32

Si Ingot 소재 양산 성공 및 공급 개시 ①

1) “SD9+P”



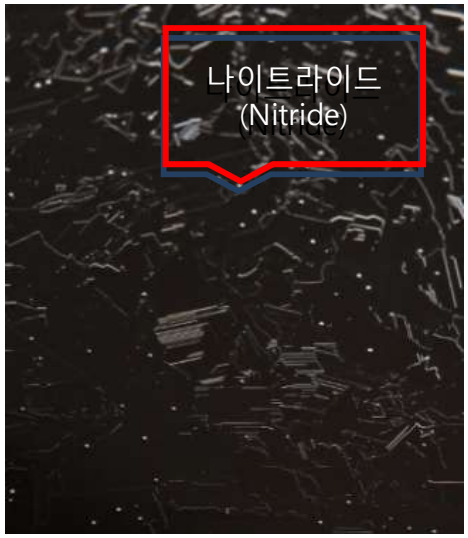




BCnC



Japan M社



China F社



Korea 타社

비씨엔씨(주) 1124 김세익 BCNC-182 2026-11-10, 17:12:33

Si Ingot 소재 양산 성공 및 공급 개시 ②

2) "SD9+S"

반도체용 Single Si(단결정 실리콘 소재) 소재 및 부품 수직 계열화 (2024년)

- **BCnC Single Si Ingots**
  - 직경 300mm 이상의 다양한 제품 생산
  - 자동화 프로그램을 이용한 잉곳 자동 생산관리
  - 20년 이상의 단결정 생산 기술 전문 지식 적용





☆ Si 소재 개발 의미

반도체 식각(etching) 공정의 다양한 핵심 소재와 제품을 모두 수직계열화한 세계 유일 기업

반도체 식각 공정 핵심 소재			
구 분	쿼츠(Q`tz)	실리콘(Si)	실리콘카바이드(SiC)
기존 소재	천연쿼츠	실리콘	실리콘카바이드
BCnC	QD9+(합성쿼츠)	SD9+P(폴리) & SD9+S(싱글)	CD9(보론카바이드)

비씨엔씨(주) 1124 김세익 BCNC-182 2026-11-10, 17:12:33

Si Ingot 소재 양산 성공 및 공급 개시 ②

1) SD9 특허 보유 현황

특허 명칭 (등록번호)
1. 실린더형 실리콘 잉곳 제조 방법 (제10-2502863호)
2. 실린더 형상의 실리콘 잉곳 제조 장치 및 제조 방법 (제10-2612255호)
3. 圓筒形矽錠的製造方法 (제I851416호)
4. シリンダ状シリコンインゴット製造方法 (제7680776호)
5. 실린더형 실리콘 잉곳 제조 방법 (제10-2820451호)
6. 반도체 제조용 부품의 직접 접합 방법 (제10-2841339호)
7. Cylindrical silicon ingot manufacturing method (제10-2487220호)

국내 특허 4건, 해외 특허 3건

비씨엔씨(주) 1124 김세익 BCNC-182 2026-11-10, 17:12:33

BC-T1: 보론 계열 백앤드용 세라믹 소재 개발

1) "BC-T1" 란?

- 차세대 디바이스 검사를 위한 보론 계열 백앤드용 세라믹 소재이며, BCnC에서 명명
- 기존 폴리머 수지 계열 소재 대체 → 파운드리 차세대 디바이스 백앤드공정 검사용 (Boron Ceramic – Test 1)

■ 세라믹 소재의 우수성

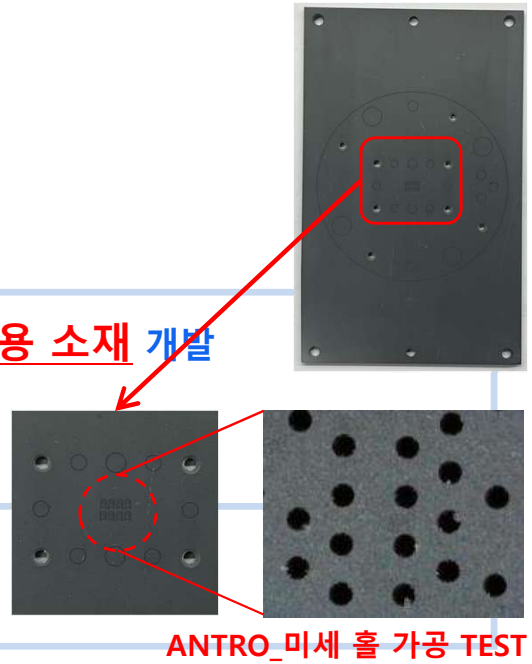
수지계열 소재	구분	세라믹 소재
누설 전류 발생 (미세화, 고단화 공정에 취약)	차세대 디바이스 대응력	뛰어난 절연성

BC-T1

뛰어난 절연 능력과 미세 가공이 가능한 세라믹 소재

2) BC-T1 사업화 전략

개발 제품	- 반도체 테스트 장비용 차세대 디바이스 검사를 위한 세라믹 소켓용 소재 개발 - 2023년 BN계열 세라믹 분말 초도품 개발 완료 - 2026년 시제품 출시 목표
시장 규모	- 글로벌 첨단 세라믹 시장 규모는 14.5조원, - 반도체 테스트 소켓용 소재 국내 시장 규모 700억원 (2021년 기준)



ANTRO_미세 홀 가공 TEST

비씨엔씨(주) 1124 김세익 BCNC-182 2026-11-10, 17:12:34

BEST
CREDIT &
CREATIVITY

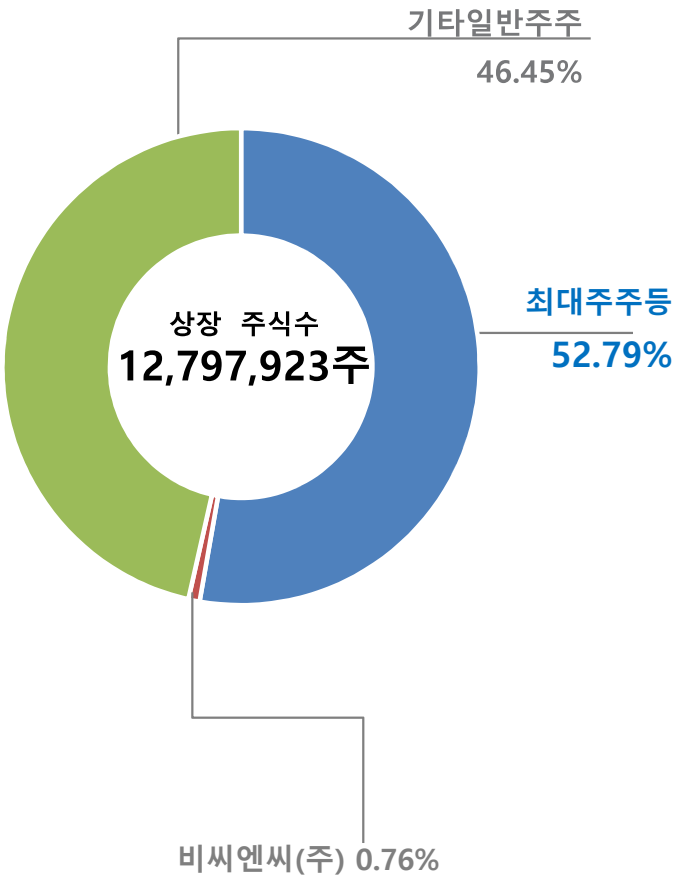
반도체 신소재 부품의 GAME CHANGER

Appendix

1. 주주현황
2. 생산시설 및 부지현황 ①,②
3. 요약 별도재무제표
4. 요약 연결재무제표



1. 주주현황



구분	주주명	주식수	지분율
최대주주 등	김돈한	5,187,513	40.53%
	김동석	1,568,423	12.26%
	소계	6,755,936	52.79%
비씨엔씨(주)		97,419	0.76%
기타일반주주		5,944,568	46.45%
합계		12,797,923	100%

* 2026년 11월 02일 기준

비씨엔씨(주) 1124 감세악 BCNC-182 2026-11-10, 17:12:34

2. 생산시설 및 부지현황 ①

부품 생산 CAPA 목표
(2025년 1,700억원/년 ~ 2027년 3,000억원/년)

구 분	면 적
보유토지	48,280m2 (14,630평)

1) 마교리 부지



비씨엔씨(주) 1124 감세악 BCNC-182 2026-11-10, 17:12:34

2. 생산시설 및 부지현황 ②

2) 소정리 부지



비씨엔씨(주) 1124 김세익 BCNC-182 2026-11-10, 17:12:34

Appendix

3. 요약 별도재무제표

요약 재무상태표

(단위: 백만원)

구분	2023	2024	2025	2026 3Q
유동자산	32,872	38,840	57,404	69,991
비유동자산	96,812	118,779	115,253	125,078
자산총계	**129,684**	**157,619**	**172,657**	**195,069**
유동부채	36,821	54,422	61,547	82,311
비유동부채	17,203	29,108	31,510	32,471
부채총계	**54,025**	**83,530**	**93,057**	**114,782**
자본금	6,380	6,396	6,399	6,399
자본잉여금	40,512	40,655	40,676	40,676
기타자본	867	1,011	5,073	2,787
이익잉여금	27,899	26,028	27,452	30,426
자본총계	**75,659**	**74,090**	**79,600**	**80,287**
유동비율	**89%**	**71%**	**93%**	**85%**
부채비율	**71%**	**112%**	**117%**	**143%**

요약 손익계산서

(단위: 백만원)

구분	2023	2024	2025	2026 3Q
매출액	**62,645**	**75,500**	**85,159**	**80,628**
매출원가	51,462	64,808	70,296	67,018
매출총이익	11,182	10,692	14,864	13,610
판매비와관리비	11,068	12,483	10,697	9,066
영업이익	**114**	**-1,790**	**4,166**	**4,545**
영업이익률	**0.2%**	**-2.3%**	**4.9%**	**5.6%**
EBITDA	4,878	5,715	13,882	12,035
EBITDA 마진	7.8%	7.6%	16.3%	14.9%
영업외수익	591	1,136	856	2,131
영업외비용	1,460	3,345	5,474	4,314
법인세비용 차감전순이익	-754	-3,999	-452	2,362
법인세비용(수익)	(2,220)	(2,073)	(1,463)	(611)
당기순이익	**1,466**	**-1,926**	**1,011**	**2,973**

주1) EBITDA는 포괄손익계산서상 영업이익 + 주석상 감가상각비와 무형자산상각비로 계상하였음

비씨엔씨(주) 1124 감세악 BCNC-182 2026-11-10, 17:12:34

Appendix

4. 요약 연결재무제표

요약 재무상태표

(단위: 백만원)

구분	2023	2024	2025	2026 3Q
유동자산	38,154	42,806	61,292	72,394
비유동자산	96,264	119,011	116,216	124,706
자산총계	**134,417**	**161,817**	**177,509**	**197,100**
유동부채	41,836	58,608	65,961	83,075
비유동부채	17,807	30,007	32,756	33,377
부채총계	**59,643**	**88,615**	**98,717**	**116,452**
자본금	6,380	6,396	6,399	6,399
자본잉여금	41,220	41,363	41,383	41,383
자기주식및 기타자본	344	488	4,550	4,564
기타포괄손익 누계액	69	376	315	176
이익잉여금	26,523	24,294	25,864	27,856
비지배지분	238	284	279	270
자본총계	**74,774**	**73,202**	**78,791**	**80,648**
유동비율	**91%**	**73%**	**93%**	**87%**
부채비율	**80%**	**121%**	**125%**	**144%**

요약 손익계산서

(단위: 백만원)

구분	2023	2024	2025	2026 3Q
매출액	**65,312**	**77,373**	**87,584**	**80,449**
매출원가	52,234	64,847	71,172	64,842
매출총이익	13,078	12,526	16,411	15,607
판매비와관리비	13,120	14,588	12,484	10,462
영업이익	**-42**	**-2,062**	**3,927**	**5,145**
영업이익률	**-1%**	**-2.6%**	**4.5%**	**6.4%**
EBITDA	5,565	6,320	14,564	13,239
EBITDA 마진	8.5%	8.2%	16.6%	16.5%
영업외수익	597	1,121	852	1,013
영업외비용	1,603	2,945	5,200	4,690
법인세비용 차감전순이익	-1,048	-3,886	-421	1,468
법인세비용(수익)	(2,321)	(1,616)	(1,571)	(530)
당기순이익	**1,273**	**-2,270**	**1,151**	**1,998**

주1) EBITDA는 포괄손익계산서상 영업이익 + 주석상 감가상각비와 무형자산상각비로 계상하였음

비씨엔씨(주) 1124 감세악 BCNC-182 2026-11-10, 17:12:34

Thank you!

본사: 이천시 신둔면 마소로57번길 25
여의도 사무실: 서울시 영등포구 여의대로 108 파크원타워1, 5층
연락처: 031-645-1504
이메일: ir@bcnc.co.kr
홈페이지: http://www.bcnc.co.kr/

비씨엔씨(주) 1124 감세악 BCNC-182 2026-11-10, 17:12:34